

北京市金杜律师事务所
关于通富微电子股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
补充法律意见书（二）

致：通富微电子股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）接受通富微电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“通富微电”或“公司”）委托，作为发行人以发行股份方式购买国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的南通通润达投资有限公司（以下简称“通润达”）47.63%股权和南通富润达投资有限公司（以下简称“富润达”）49.48%股权并向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金所涉及的有关事项（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问，已于2016年10月18日出具《北京市金杜律师事务所关于南通富士通微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”），并就中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年12月8日下发的163440号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）提出的有关法律问题及相关事项于2016年12月21日出具《北京市金杜律师事务所关于南通富士通微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）。

根据2017年1月4日召开的中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2017年第1次会议的审核结果，本次重大资产重组有条件通过。金杜现根据并购重组委提出的审核意见，出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对《法律意见书》及《补充法律意见书（一）》相关内容的补充，并构成《法律意见书》及《补充法律意见书（一）》不可分割的一部

分。金杜在《法律意见书》及《补充法律意见书（一）》中发表法律意见的前提、假设和有关用语释义同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供发行人为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。

金杜按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次交易相关各方提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具补充法律意见如下：

一、 请申请人补充说明本次交易募集配套资金投向通富超威苏州的具体形式，项目开展是否存在障碍。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。

（一） 本次交易募集配套资金投向通富超威苏州的具体形式

上市公司拟通过借款方式将本次交易募集配套资金投向通富超威苏州，进而实施本次交易的募集配套资金投资项目。

上市公司于 2016 年 1 月 12 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向苏州通富超威半导体有限公司提供借款的议案》，同意通富微电以合法方式向通富超威苏州提供不超过人民币 9.69 亿元的借款，用于已经批准的智能移动终端及图像处理等集成电路封装测试项目（不超过人民币 4.03 亿元）和高性能中央处理器等集成电路封装测试项目（不超过人民币 5.66 亿元），借款资金来源为通富微电发行股份购买资产而募集的配套资金。若募集资金到位时间与项目实施进度不一致，可由通富微电或通富超威苏州根据实际情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。其中，借款期限为 5 年，到期后上市公司可根据届时证监会、深交所及上市公司相关规定（如有）借予通富超威苏州滚动使用。借款利率按《借款协议》签署时中国人民银行同期贷款基准利率确定。借款本息的还款资金来源为通富超威苏州的自有资金。

（二） 项目开展是否存在障碍

1. 上市公司以借款方式将本次交易募集配套资金投向通富超威苏州进行相关募投项目建设已获得通富超威苏州董事会全体成员的一致同意

2017 年 1 月 6 日，通富超威苏州董事会全体成员一致同意并签署《苏州通富超威半导体有限公司董事会书面决议》，具体内容如下：

“鉴于：董事会于 2016 年 9 月 30 日批准通富超威苏州从通富微电子股份有限公司（以下简称“通富微电”）筹集资金最高达到约 4.03 亿元人民币，用于《智能移动终端及图像处理等集成电路封装测试项目》；批准通富超威苏州从通富微电筹集资金最高达到约 5.66 亿元人民币，用于《高性能中央处理器等集成电路封装测试项目》。

决议：董事会批准通富微电以合法方式向通富超威苏州提供不超过人民币 9.69 亿元的借款，用于已经批准的智能移动终端及图像处理等集成电路封装测试项目（不超过人民币 4.03 亿元）和高性能中央处理器等集成电路封装测试项目（不超过人民币 5.66 亿元），借款资金来源为通富微电发行股份购买资产而募集的配套资金。若募集资金到位时间与项目实施进度不一致，可由通富微电或通富超威苏州根据实际情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。其中，借款期限为 5 年，到期后可滚动使用。借款利率按《借款协议》签署时中国人民银行同期贷款基准利率确定。借款本息的还款资金来源为通富超威苏州的自有资金。”

2. 本次交易募投项目已履行必要的项目投资政府审批程序

（1）智能移动终端及图像处理等集成电路封装测试项目

2016 年 9 月 21 日，苏州工业园区经济发展委员会下发《企业投资项目备案通知书》（备案号：3205101604696），对该项目予以备案，备案有效期为两年。

2016 年 11 月 11 日，苏州工业园区国土环保局下发《建设项目环保审批意见》（档案编号：002213700），同意该项目建设，批复有效期为五年。

2016 年 11 月 24 日，苏州工业园区经济发展委员会下发《苏州通富超威半导体有限公司智能移动终端及图像处理等集成电路封装测试项目节能评估报告书的审查意见》（苏园经能审[2016]36 号），同意该项目节能评估报告书。

（2）高性能中央处理器等集成电路封装测试项目

2016 年 9 月 21 日，苏州工业园区经济发展委员会下发《企业投资项目备案通知书》（备案号：3205101604695），对该项目予以备案，备案有效期为两年。

2016 年 11 月 14 日，苏州工业园区国土环保局下发《建设项目环保审批意见》（档案编号：002213800），同意该项目建设，批复有效期为五年。

2016年11月24日，苏州工业园区经济发展委员会下发《苏州通富超威半导体有限公司高性能中央处理器等集成电路封装测试项目节能评估报告书的审查意见》（苏园经能审[2016]37号），同意该项目节能评估报告书。

基于上述，金杜认为，本次交易募投项目已经履行了现阶段应当履行的项目投资政府审批程序。除上述备案、环评及能评程序外，上述项目的建设尚需就其改扩建取得建设工程规划许可证和建设工程施工许可证。经通富超威苏州和通富超威槟城确认，该等建设工程规划许可证和建设工程施工许可证将于开工建设前办理，且其办理不存在实质性障碍。

（3）通富超威苏州具备实施本次交易募投项目的场地及相关技术条件

a. 通富超威苏州具备实施本次交易募投项目的场地

根据通富超威苏州的说明，智能移动终端及图像处理等集成电路封装测试项目及高性能中央处理器等集成电路封装测试项目均在通富超威苏州现有厂区内进行建设，无需另行购置土地，通富超威苏州具备建设本次交易募投项目的相关场地。

b. 通富超威苏州具备实施本次交易募投项目的相关技术

根据通富超威苏州的说明，智能移动终端及图像处理等集成电路封装测试项目的主要建设内容为FCBGA（21*21）产品封装测试生产线及其相关生产用房，产品主要用于手机、Pad、独立显卡等领域。

根据通富超威苏州的说明，高性能中央处理器等集成电路封装测试项目的主要建设内容为FCBGA（29*29）、FCBGA（35*35）产品封装测试生产线及其相关生产用房，产品主要用于CPU、网关服务器、基站处理器、游戏机等领域。

根据通富超威苏州的说明，通富超威苏州主要从事CPU、GPU、APU、游戏机芯片等高端产品的封装测试业务，其在先进封装领域具有较强的技术优势，经过多年的发展积累，形成了以倒装封装为主的技术线路，主要量产的封装形式包括FCBGA、FCPGA、FCLGA、MCM，具备实施本次募投项目的相关技术条件。

综上，上市公司同意通过借款方式将本次交易募集配套资金投向通富超威苏州实施本次交易的募投项目，相关议案已经上市公司董事会审议通过；本次交易募投项目的实施、资金来源及投入方式获得了通富超威苏州董事会全体董事的一致同意并形成了相关决议，履行了现阶段应当履行的项目投资政府审批程序，且

通富超威苏州具备实施本次交易募投项目的场地及相关技术条件。基于上述，金杜认为，上市公司通过借款方式将本次交易募集配套资金投入通富超威苏州，并实施募投项目不存在实质性障碍。

本补充法律意见书正本一式五份。

（以下无正文，为签字盖章页）

（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于通富微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（二）》之签字盖章页）

北京市金杜律师事务所

经办律师：_____

莫海波

徐 辉

单位负责人：_____

王 玲

二〇一七年一月十二日